

マイクロン、インテルと共同で高性能オンパッケージメモリソリューション搭載 Knights Landing を強化

次世代コンピューティング向け 低電力、最大帯域幅メモリソリューションを提供

米アイダホ州ボイシー、2014 年 6 月 24 日（GLOBE NEWSWIRE） --先進的な半導体ソリューションを提供する世界的大企業であるマイクロン テクノロジー社（Nasdaq:MU）は本日、コードネーム **Knights Landing** と名づけられたインテルの次世代 **Xeon Phi(TM)** プロセッサ向けオンパッケージメモリソリューションを提供するため、インテル社と共働していることを発表しました。2 社はこれまでマイクロンのハイブリッドメモリキューブ製品にも用いられている基本的な **DRAM** およびスタッキング技術を活用してメモリウォールの打破に取り組んでおり、このメモリソリューションはこうした長期にわたる 2 社の努力が実ったものです。

IDC のリサーチマネージャー **Chirag Dekate** 氏は次のように述べています。「エコシステムは変化を続けており、現在、スケーラブルなオンパッケージメモリとメモリ帯域幅の重要性は今や誰でもが知っていることですメモリは、ビッグコンピュータとビッグデータいずれにも寄与するソリューションスペースの要です。この発表は、システムにおけるメモリの役割および影響、そして 3D メモリが実現可能な価値を、マイクロンがいかに向上させているかを明らかに証明しています」

DDR4 と比較して 5 倍の継続メモリ帯域幅、ビットあたり 3 分の 1 の電力消費量、半分の設置面積を実現した **Knights Landing** の高性能パッケージメモリは、高速ロジックおよび **DRAM** レイヤを最適化されたひとつのパッケージに統合し、性能と電力効率の点で業界における新たなベンチマークとなります。このメモリスタックは、高性能コンピューティングシステムに必須の要素である、信頼性、可用性、保守性を最適な水準で提供します。**Knights Landing** システム（次世代 **Cray XC** スーパーコンピュータ）の最初のアプリケーションのひとつは、**NERSC** により 4 月 29 日に発表されています。

マイクロンのコンピュータおよびネットワーキングビジネスユニット担当副社長の **Tom Eby** 氏は次のように述べています。「インテルのメニー・インテグレートッド・コア（MIC）アーキテクチャとマイクロンの高性能メモリは素晴らしい組み合わせです。インテルとマイクロンの最新技術によってプロセッサとメモリシステムが見事に融合した結果、極めて難しい低電力と最大帯域幅の両立を実現したのです」

インテル社の副社長、ゼネラルマネージャー、ワークステーション・高性能コンピューティングデータセンターグループ担当の Charles Wuischpard 氏は、次のように述べています。「コードネーム Knights Landing の次世代 Intel(R) Xeon Phi(TM) プロセッサは、当初から最大で 16GB の高性能、かつ DDR4 と比較して継続メモリ帯幅域が劇的に向上したオンパッケージメモリを提供し、大幅な省電力と省スペースを実現します。この新しい高性能オンパッケージメモリを用いた最初のインテル HPC プロセッサにより、世界トップレベルの研究者、科学者、エンジニアの皆様には、現在のコードに対する投資を失うことなく、より大きなワークロードをより速く実行いただけます。当社は、それをお届けするためにマイクロンと協力していることを嬉しく思っています」

マイクロンによる高性能メモリソリューションに関する詳細情報は、<http://www.micron.com/products/hybrid-memory-cube> をご覧ください。

マイクロンについて

マイクロン テクノロジー社は、先進的な半導体システムを提供する世界的大手企業です。DRAM、NAND、NOR フラッシュを含むマイクロンの幅広い高性能メモリテクノロジーポートフォリオは、ソリッドステートドライブ、モジュール、マルチチップパッケージ、その他のシステムソリューションの基礎になっています。35 年以上にわたるテクノロジー分野でのリーダーシップにより、マイクロンのメモリソリューションは世界で最も革新的なコンピュータ、コンシューマ、エンタープライズストレージ、ネットワーキング、モバイル、組み込みおよび車載アプリケーションを実現しています。マイクロン テクノロジー社の普通株式は NASDAQ にて MU のコード名で上場取引されています。マイクロン テクノロジー社に関する情報は www.micron.com をご覧ください。

© 2014 年 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 情報は予告なく変更されることがあります。Micron および Micron の軌道ロゴは Micron Technology, Inc. の商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。このニュースリリースには、高性能オンパッケージメモリの入手可能性に関する将来予測の記述が含まれています。実際の出来事や結果は、将来予測の記述に含まれる内容と大きく異なる可能性があります。マイクロンが米証券取引委員会に対し随時提出する連結ベースの書類、具体的にはマイクロン最新のフォーム「10-K」と「10-Q」をご覧ください。これらの書類は、マイクロンによる連結ベースの実際の結果と「将来予測」に記載されたものが大きく異なる原因となり得る重要な要因を含むと共に、それらを特定しています（「特定の要因」を参照）。当社は「将来予測」

に示された期待は妥当だと考えておりますが、将来の結果、活動のレベル、実績、あるいは成果を保証するものではありません。

お問い合わせ先：PR 担当：

Greg Wood

Zeno Group for Micron Technology

650-801-7958

Greg.Wood@zenogroup.com